

お問い合わせ先
OBARA GROUP株式会社
〒242-0007 神奈川県大和市中央林間3-2-10
TEL. 046-271-2122

適切に管理された森林からの原料を含むFSC®認証紙之環境に配慮した植物油インキを使用
しています。



www.obara-g.com

OBARA-G REPORT

第65期 第2 四半期報告書

2022年10月1日………2023年3月31日

証券コード 6877

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。OBARA GROUPの2023年第2四半期連結累計期間における事業の概況等をご報告致します。

世界経済は、一部地域において新型コロナウイルス感染症の流行により経済活動が抑制されましたが、総体的には緩やかな回復基調となりました。

我が国経済につきましては、生産活動に弱含んだ動きが見られたものの、個人消費や設備投資に持ち直しの兆しが見られるなど、景気に回復の動きが見られました。

そのような外部環境の下、溶接機器関連事業が、自動車メーカーの前向きな設備投資計画への対応に努め、平面研磨装置関連事業が、安定的な生産活動や設備投資が続くエレクトロニクス関連素材への拡販活動を図ったことなどにより、当社の業績は、前年同期を上回る結果となりました。

なお、当社は株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要政策として認識しており、2023年度の第2四半期末配当金につきましては、2023年4月24日に公表の通り、業績が順調に推移したことなどから、1株当たり第2四半期末配当金を当初予想より20円増配の60円とし、本年6月5日を支払開始日とさせていただきます。



今後も不透明な経済環境が予想されますが、当社と致しましては、引き続き成長市場への経営資源の投入を積極的に推進し、顧客ニーズを満たす製品及びサービスの提供を行うことにより、業績向上に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、OBARA GROUPへの倍日のご支援を心よりお願い申し上げます。

2023年6月

取締役社長 小原 康嗣

目次	株主の皆様へ ▶ 01	セグメント別事業概況 ▶ 05	連結財務データ ▶ 11	株式情報 ▶ 15	インフォメーション ▶ 17
	営業の概況 ▶ 03	主要経営指標の推移 ▶ 09	会社情報 ▶ 14	株主メモ ▶ 16	



連結業績サマリー

(百万円)

	第2四半期累計期間			通期		
	前期	当期	前年同期比	前期	当期(予想)	前期比
売上高	22,170	29,467	32.9%	50,282	53,500	6.4%
営業利益	3,482	5,537	59.0%	8,497	8,950	5.3%
経常利益	3,918	5,679	44.9%	9,657	9,600	△0.6%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	2,316	3,980	71.8%	6,197	6,400	3.3%
1株当たり配当金	40円	60円	—	130円(年間)	150円(年間)	—

(注) 前期の期末配当金(確定)／1株当たり配当金90円
 当期の期末配当金(予想)／1株当たり配当金90円

03

第2四半期連結累計期間の概況について

当社グループと深く関わる自動車業界につきましては、世界各地で電動化対応を含め、設備投資計画が継続しました。一方、同じく当社グループと深く関わるエレクトロニクス業界では、半導体メモリ等の市況軟化が見られる中、半導体デバイス向け設備投資計画に調整的な動きも見られました。

当社グループは、このような経営環境において各市場動向に応じた拡販に努め、ローカルニーズに対応した製品投入を進めたことなどにより、第2四半期連結累計期間の業績は前年同期を上回る結果となりました。

通期の見通しについて

当社グループと深く関わる自動車業界では、市場環境の急速な変化に対し新型車投入が継続されていますが、通商問題などへの懸念から、車体組立設備において、堅調ながらも慎重な投資動向が予想されます。また、同じく当社グループと深く関わるエレクトロニクス業界では、デジタル化の流れが世界的に進行する中、エレクトロニクス関連素材において、堅調な設備投資が予想されます。

そのような環境下、当社グループの通期業績につきましては、期初計画の水準を予想しておりますが、当社グループとしましては、成長市場での販売促進を鋭意図るとともに、継続的に設備投資と研究開発を行ってまいります。

なお、当連結業績予想は、1米ドル=132.00円の為替レートを前提としています。

04

セグメント別事業概況

溶接機器
関連事業

事業紹介

溶接機器関連事業とは

自動車業界を主要マーケットとする高効率な抵抗溶接機器を製造・販売しています。

自動車が出来るまで

●溶接機器関連事業と関わる自動車の製造プロセス

車体溶接

塗装

ぎ装

完成

出荷



OBARA GROUP が提供する溶接機器

自動車ボディは薄板鋼板で構成されるため、抵抗溶接という接合工法が採用されています。

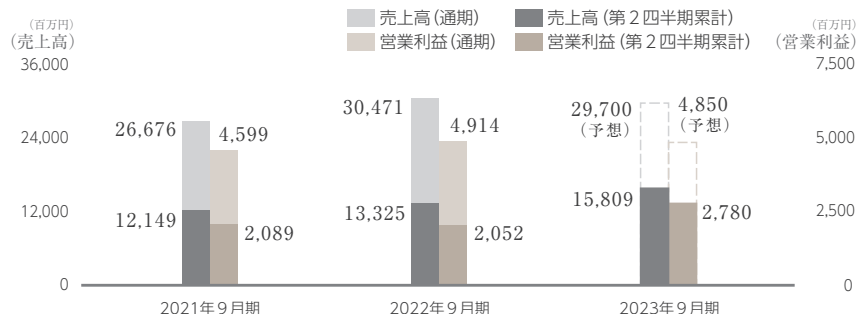
抵抗溶接は、接合ポイントに適切な加圧力と溶接電流を与える必要があります。自動車ボディの組立てには、各自動車モデル固有の立体形状に合わせ、個々の接合ポイントにカスタマイズされた溶接機器が設計・製造されます。

私たちは、国内外の自動車メーカーが行う設備増強やモデルチェンジに伴う設備更新に対し、半世紀に亘って培った経験と最先端の設計・生産技術により、最適な抵抗溶接設備を提案します。日々の生産活動に不可欠な消耗品と合わせ、自動車業界のパフォーマンス要望に応えます。

溶接機器関連事業



溶接ガン



売上高構成比



溶接機器関連事業につきましては、取引先である自動車業界において、アジア地域等で堅調な生産活動が見られ、車体組立分野の設備投資についても総じて強含んだ推移となりました。

このような環境の下、当事業として設備品及び消耗品の拡販を図ったことなどにより、業績は堅調に推移しました。

この結果、当事業の売上高は158億9百万円(前年同期比18.6%増)、同営業利益は27億80百万円(前年同期比35.5%増)となりました。

セグメント別事業概況

平面研磨装置
関連事業

事業紹介

平面研磨装置関連事業とは

エレクトロニクス業界を主要マーケットとする精密研磨装置を製造・販売しています。

エレクトロニクス製品が出来るまで

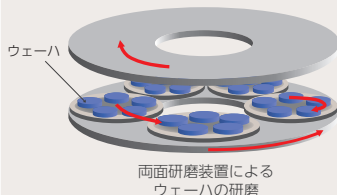
●平面研磨装置関連事業と関わるエレクトロニクス製品の製造プロセス

ウェーハ製造工程
インゴット引き上げ、切断、
ウェーハ研磨

半導体デバイス前工程
成膜、リソグラフィ、
エッチング等

半導体デバイス後工程
ダイシング、ボンディング、
モールドイング等

エレクトロニクス製品組込
完成した半導体デバイス(チップ)の
エレクトロニクス製品への搭載

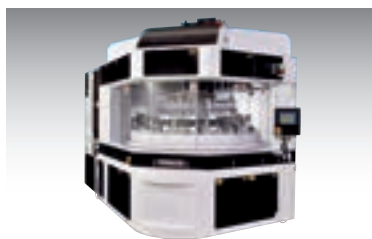


OBARA GROUP が提供する平面研磨装置

精密加工により製造される先端エレクトロニクス製品は、材料段階で高い面精度を基準平面として要求します。ロジックチップ・メモリーなどの半導体デバイスに用いられるシリコンウェーハ、通信・光デバイス基板、ハードディスク基板など、多様なエレクトロニクス素材の面精度の形成に、ダメージのない微細加工が可能な、遊離砥粒研磨装置が活躍しています。

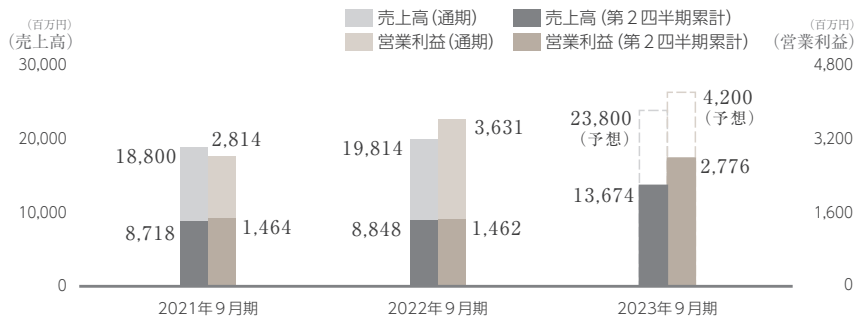
現代社会を支える各種エレクトロニクス素材の期待水準に、私たちは、ナノオーダー対応の遊離砥粒研磨装置を中心とした精密装置ラインナップで応えます。また、信頼性の高い量産プロセスの確立に必要な、スラリー・研磨パッドなどの消耗副資材も開発・販売しています。

平面研磨装置関連事業



両面研磨装置

売上高構成比

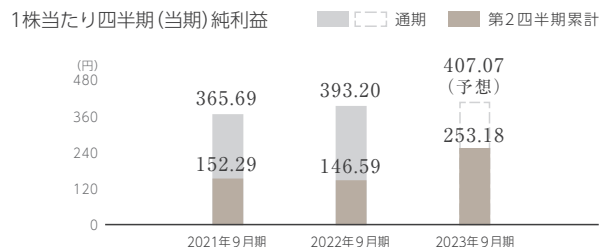
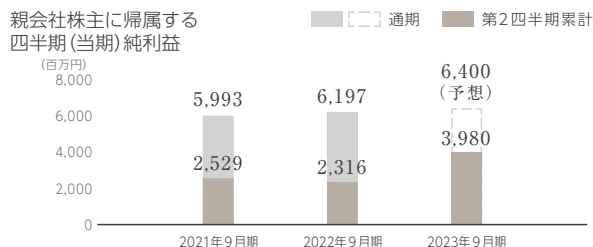
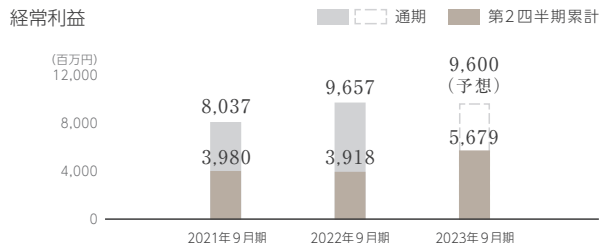
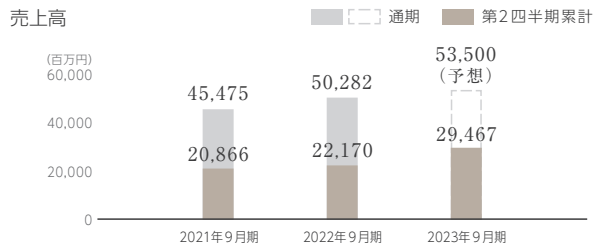


平面研磨装置関連事業につきましては、高度半導体デバイスにおける用途の多様化などを背景とし、取引先であるエレクトロニクス関連素材において、安定的な生産活動や設備投資が続きました。このような環境の下、当事業として顧客要求に適合した製品の販売促進に努めたことなどにより、業績は堅調に推移しました。

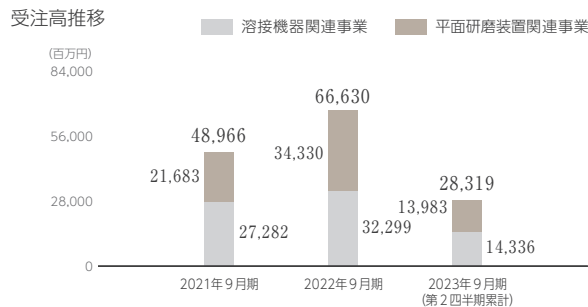
この結果、当事業の売上高は136億74百万円(前年同期比54.5%増)、同営業利益は27億76百万円(前年同期比89.8%増)となりました。

主要経営指標の推移

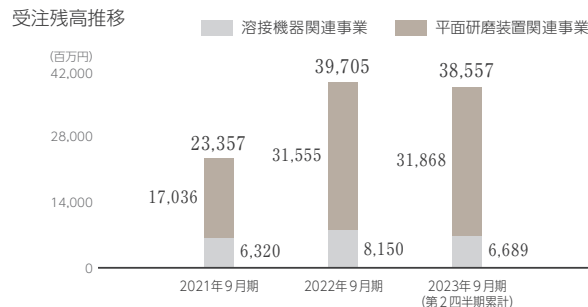
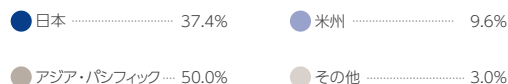
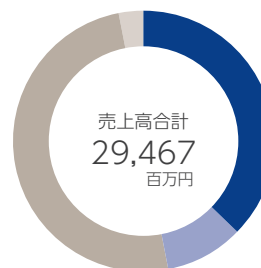
詳細情報は当社IRサイトをご覧ください。 <http://www.obara-g.com/jp/ir/library/index.html>



09



地域別売上高構成比



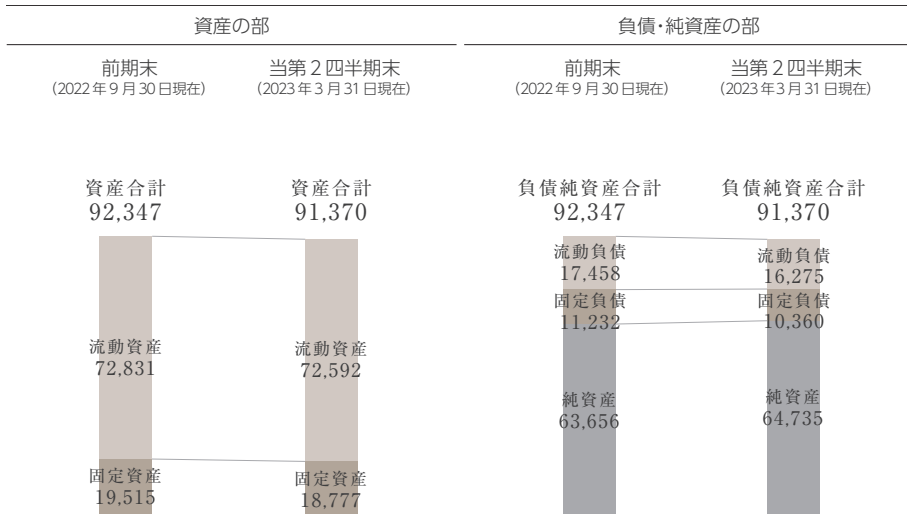
(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

10



資産・負債・純資産の状況

(単位：百万円)



point
1

資産負債

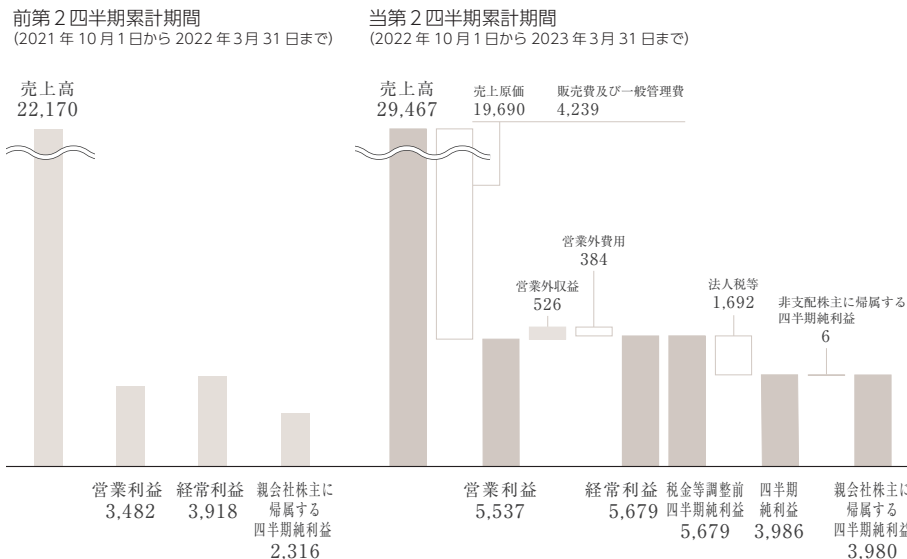
総資産は913億70百万円と、前期末に比べて9億76百万円減少しました。

電子記録債権が13億99百万円、流動資産のその他が4億37百万円増加した一方、現金及び預金が10億44百万円、棚卸資産が10億円、建物及び構築物(純額)が3億72百万円減少したことなどによります。

負債は266億35百万円と、前期末に比べて20億55百万円減少しました。未払法人税等が2億20百万円増加した一方、契約負債が7億87百万円、賞与引当金が3億58百万円、流動負債のその他が3億25百万円、繰延税金負債が7億21百万円減少したことなどによります。

損益の状況

(単位：百万円)



point
2

純資産

純資産は647億35百万円と、前期末に比べて10億79百万円増加しました。為替が前期末より円高のため、為替換算調整勘定が15億39百万円減少した一方、利益剰余金が25億65百万円増加したことなどによります。

point
3

売上高・営業利益・
経常利益・親会社株主に
帰属する四半期純利益

売上高294億67百万円(前年同期比32.9%増)、営業利益55億37百万円(前年同期比59.0%増)、経常利益56億79百万円(前年同期比44.9%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は、39億80百万円(前年同期比71.8%増)となりました。

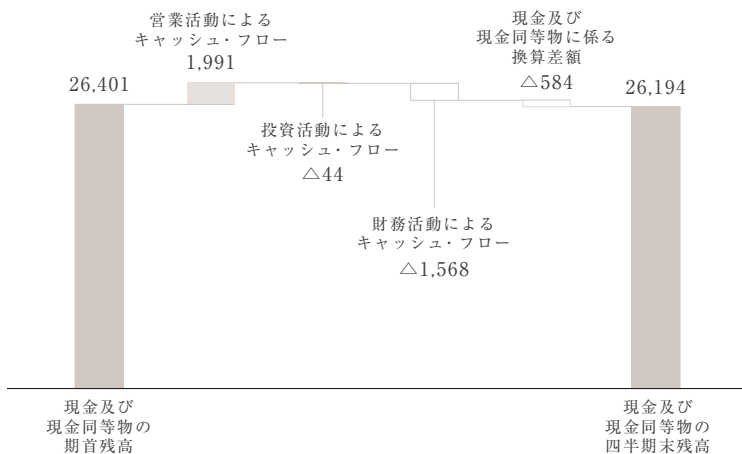
連結財務データ

キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間

(2022年10月1日から2023年3月31日まで)

(単位：百万円)



point
4

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は19億91百万円となりましたが、前年同期に比べ2億71百万円の収入減少となりました。売上債権の増加額が18億85百万円、契約負債の減少額が6億23百万円、法人税等の支払額が23億62百万円となった一方、税金等調整前四半期純利益が56億79百万円、減価償却費及びその他の償却費が6億64百万円、棚卸資産の減少額が6億51百万円発生したことなどによります。

point
5

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により支出した資金は44百万円となり、前年同期に比べ19億63百万円の支出減少となりました。定期預金の純減少額が3億91百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入が5億9百万円となった一方、有形固定資産の取得による支出が3億69百万円、投資有価証券の取得による支出が5億円、その他投資活動による支出が81百万円発生したことなどによります。

point
6

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により支出した資金は15億68百万円となり、前年同期に比べ7億39百万円の支出減少となりました。配当金の支払額が14億15百万円発生したことなどによります。

会社情報

(2023年3月31日現在)

会社概要

商号	OBARA GROUP 株式会社
設立	1958年12月
資本金	19億25百万円
従業員数	単体：19名(連結1,699名)
本社所在地	神奈川県大和市中央林間 3-2-10 046-271-2111(代表)
主な事業	持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、その他経営管理
ウェブサイト	http://www.obara-g.com/

役員

取締役社長	小原 康嗣
取締役	小林 憲史
取締役	山下 光久
社外取締役	大西 倫雄*
社外取締役	牧野 宏司*
常勤監査役	高井 清
社外監査役	須山 正志*
社外監査役	高橋 昌子*

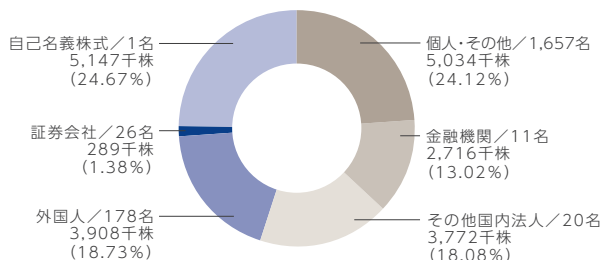
* 証券取引所が定める独立役員として届出を行っております。

株式情報 (2023年3月31日現在)

株式状況

発行可能株式総数	38,000,000株
発行済株式総数	20,869,380株
単元株式数	100株
株主数	1,893名

株主分布状況



株主メモ

事業年度	毎年10月1日から翌年9月30日まで
定時株主総会	毎年12月
基準日	定時株主総会の議決権 毎年9月30日 期末配当 毎年9月30日 第2四半期末配当 毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
株主名簿管理人	〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社
特別口座の 口座管理機関	東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱所 (郵便物送付先 お問い合わせ先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL：0120-782-031(フリーダイヤル)
同取次窓口	三井住友信託銀行株式会社 全国各本支店

大株主

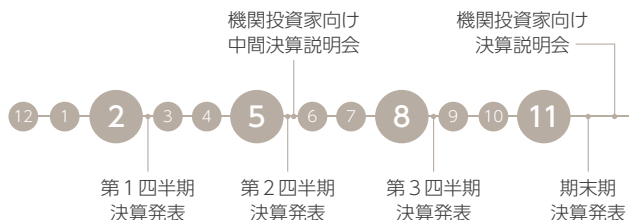
株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
有限会社馬込興産	3,703	23.55
小原 康嗣	2,571	16.35
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	2,050	13.04
JP MORGAN CHASE BANK 385632	1,453	9.24
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572	545	3.46
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	454	2.89
小原 範子	304	1.93
JP MORGAN CHASE BANK 380072	288	1.83
吉田 史子	218	1.39
RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT-CLIENT ACCOUNT	132	0.84

(注) 1. 上記のほか、自己株式5,147千株を保有しております。
2. 持株比率は、自己株式5,147千株を控除して計算しております。
3. 小原康嗣の持株数は自身の管理分株数1,084千株を加えて表示しております。

公告方法

当社公告につきましては、下記ウェブサイトに掲載致します。
<http://www.obara-g.com/>
但し、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告を行うことが出来ない場合は、日本経済新聞に公告を掲載致します。

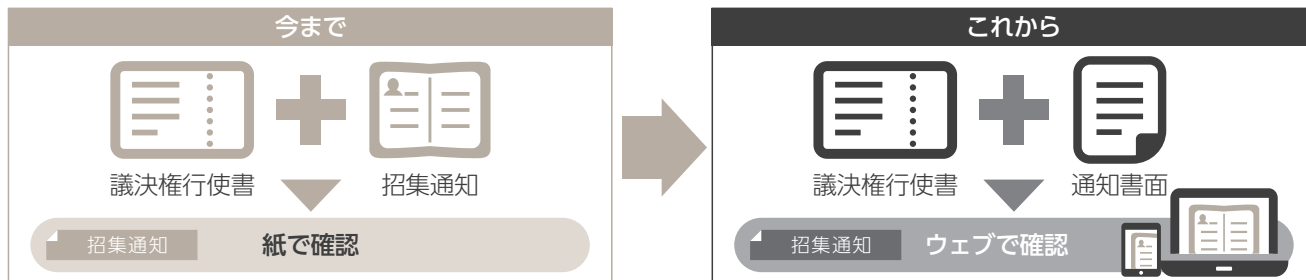
年間IRスケジュール



会社法改正により株主総会資料(招集通知)の 電子提供制度が始まります！

2023年3月以降の株主総会より、これまで郵送していた株主総会資料(招集通知)が原則ウェブ化されます。

株主の皆様は、会社から通知書面にてご案内するウェブサイトへアクセスすることで、株主総会資料をご確認いただくことが出来ます。**当社では2023年12月下旬開催予定の定時株主総会から適用となります。**



17

インターネットのご利用が困難な株主様へ

書面で受領するためのお手続き(書面交付請求)が可能です。

Q 書面交付請求とは？

インターネットを利用することが困難な株主様を保護するためのお手続きです。
お申し出いただいた株主様には株主総会資料を書面でお送りします。
なお、書面交付請求を行わなくても、URL等を記載した通知書面はお送りします。


Q 書面交付請求の 受付期限は？

株主総会の基準日(当社では9月30日)までにお申し出が必要です。
お手続きには2週間以上お時間がかかる場合がございますので、余裕をもってお手続きを行ってください。

Q お手続き方法は？

証券会社にお申し出の場合は、保有銘柄の口座を開設している証券会社へお問い合わせください。
株主名簿管理人にお申し出の場合は、書面での受領を希望される銘柄ごとに申出書面のご提出が必要です。

株主総会資料の電子提供に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行 証券代行部 電子提供制度専用ダイヤル  **0120-533-600**

受付時間 土・日・休日を除く平日9:00～17:00  <https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/>



18